

Bearbeitung von Leiterplatten



Mechanisches Bohren, Laserbohren, Fräsen und Ritzen Von Dipl.-Ing. Burghart Gerlach. Erste Auflage 2003. 144 Seiten mit 113 Abbildungen und 6 Tabellen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 49,53 €

53,00 €

Netto-Preis: 49,53 €

Enthaltene MwSt.: 3,47 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Die mechanische Bearbeitung der Leiterplatte - insbesondere das Einbringen einer zunehmenden Anzahl von Bohrungen - hat einen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit und Dauer des gesamten Herstellprozesses. Dementsprechend haben in der Vergangenheit Materialien, Verfahren und Equipment zum Bohren und Fräsen von Leiterplatten und in neuerer Zeit zum Einbringen von Microvias durch Laser-ablation eine rasante Entwicklung erfahren.

Der Autor des Buches, der fast drei Jahrzehnte lang diese Entwicklung verfolgt hat und wesentlich an ihr beteiligt war, stellt in dem Buch den gegenwärtigen Stand der Technik umfassend dar. Die einzelnen Funktionsmodule moderner Bohrautomaten werden ausführlich beschrieben und mögliche Automatisierungsmöglichkeiten zur Produktivitätssteigerung vorgestellt, ebenso die Werkzeuge und das Werkzeugmanagement. Im Kapitel Laserbohren werden die verschiedenen Verfahrensvarianten herausgearbeitet und das Verfahren gegenüber dem konventionellen Bohren abgegrenzt. Trotz vieler Gemeinsamkeiten mit dem Bohren ist das Fräsen von Leiterplatten heute ein vollkommen autarkes Fertigungsfeld und wird als solches behandelt. Im letzten Kapitel wird schließlich das Ritzfräsen als modernes Verfahren zur Nutzentrennung beschrieben.

Das Buch ist von einem Praktiker für die Praxis geschrieben.

Es wendet sich an alle in der mechanischen Bearbeitung der Leiterplattenherstellung Beschäftigten, die sich mit dem neuesten Stand der Technik vertraut machen wollen.